

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 3 区分

【発行日】平成 18 年 6 月 29 日 (2006.6.29)

【公開番号】特開 2005-15506 (P2005-15506A)

【公開日】平成 17 年 1 月 20 日 (2005.1.20)

【年通号数】公開・登録公報 2005-003

【出願番号】特願 2003-177805 (P2003-177805)

【国際特許分類】

C 0 9 J 163/00 (2006.01)

B 3 2 B 15/088 (2006.01)

B 3 2 B 27/00 (2006.01)

C 0 9 J 7/02 (2006.01)

C 0 9 J 163/10 (2006.01)

C 0 9 J 171/10 (2006.01)

【F I】

C 0 9 J 163/00

B 3 2 B 15/08 R

B 3 2 B 27/00 M

C 0 9 J 7/02 Z

C 0 9 J 163/10

C 0 9 J 171/10

【手続補正書】

【提出日】平成 18 年 5 月 12 日 (2006.5.12)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項 3

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 3】前記フェノキシ樹脂として、臭素化フェノキシ樹脂を有する請求項 1 記載の半導体装置用接着剤組成物。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項 5

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 5】請求項 1 ~ 4 のいずれか記載の半導体装置用接着剤組成物からなる接着剤層と、少なくとも 1 層の有機絶縁性フィルムを有する半導体装置用接着剤シート。

【手続補正 3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項 6

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 6】請求項 1 ~ 4 のいずれか記載の半導体装置用接着剤組成物を用いたカバレーフィロム。

【手続補正 4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項 7

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 7】請求項 1 ～ 4 のいずれか記載の半導体装置用接着剤組成物からなる接着剤層を介してポリイミドフィルムと銅箔とを接着してなる銅張りポリイミドフィルム。